

性能指标	典型值		方向	单位	条件	测试方法
	RT/duroid 6006	RT/duroid 6010.2LM				
介电常数, ϵ_r 制造过程	6.15 ± 0.15	10.2 ± 0.25	Z		10 GHz 23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5 带状线法
介电常数, ϵ_r 设计	6.45	10.7	Z		8 GHz - 40 GHz	差分相位长度方法
损耗因子 $\tan \delta$	0.0027	0.0023	Z		10 GHz/A	IPC-TM-650 2.5.5.5
ϵ_r 热温度系数	-410	-425	Z	ppm/°C	-50 to 170°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
体电阻	7X10 ⁷	5X10 ⁶		Mohm	A	IPC 2.5.17.1
表面电阻	2X10 ⁷	5X10 ⁵		Mohm · cm	A	IPC 2.5.17.1
杨氏模量						
极限拉力	627 (91) 517 (75)	931 (135) 559 (81)	X Y	MPa (kpsi)	A	ASTM D638 (0.1/min. 应变速率)
极限应力	20 (2.8) 17 (2.5)	17 (2.4) 13 (1.9)	X Y	MPa (kpsi)	A	
极限应变	12 到 13 4 到 6	9 to 15 7 to 14	X Y	%	A	
杨氏模量						
压缩	1069 (155)	2144 (311)	Z	MPa (kpsi)	A	ASTM D695 (0.05/min. 应变速率)
极限应力	54 (7.9)	47 (6.9)	Z	MPa (kpsi)	A	
极限应变	33	25	Z	%		
弯曲模量	2634 (382) 1951 (283)	4364 (633) 3751 (544)	X	MPa (kpsi)	A	ASTM D790
极限压力	38 (5.5)	36 (5.2) 32 (4.4)	X Y	MPa (kpsi)	A	
载荷变形	0.33 2.10	0.26 1.37	Z Z	%	24 hr/ 50°C/ 7MPa 24 hr/ 150°C/ 7 MPa	ASTM D261
吸水率	0.05	0.01		%	D48/50°C, 0.050" (1.27mm) 厚	IPC-TM-650, 2.6.2.1
密度	2.7	3.1		g/cm ³		ASTM D792
热导率	0.49	0.86		W/m/°K	80°C	ASTM C518
热膨胀系数	47 34, 117	24 24, 47	X Y,Z	ppm/°C	0 to 100°C	ASTM 3386 (5K/min)
Td	500	500		°C TGA		ASTM D3850
比热	0.97 (0.231)	1.00 (0.239)		J/g/K (BTU/lb/°F)		计算所得
铜箔剥离强度	14.3 (2.5)	12.3 (2.1)		pli (N/mm)	漂锡后	IPC-TM-650 2.4.8
阻燃性	V-0	V-0				UL94
无铅焊接兼容	是	是				

标准厚度	标准尺寸	标准覆铜厚度及类型
0.005" (0.127mm) 0.010" (0.254mm) 0.025" (0.635mm) 0.050" (1.27mm) 0.075" (1.90mm) 0.100" (2.50mm)	10" X 10" (254 X 254mm) 10" X 20" (254 X 508mm) *20" X 20" (508 X 508mm) - 非标准 18" X 12" (457 X 305 mm) *18" X 24" (457 X 610 mm) - 非标准 (*注意: 以上两个尺寸仅可提供>0.025"的厚度)	½ oz. (18 µm), 1 oz. (35µm), 2 oz. (70µm) 电沉积&反转铜 根据介质厚度, 可以使用厚金属覆层, 请联系 罗杰斯客服中心。
可提供非标准厚度		

如您需要微波高频线路板的技术支持或报价服务, 请联系 iPcb.cn, 邮箱:sales@ipcb.cn 或者进入网站自动报价: www.ipcb.cn